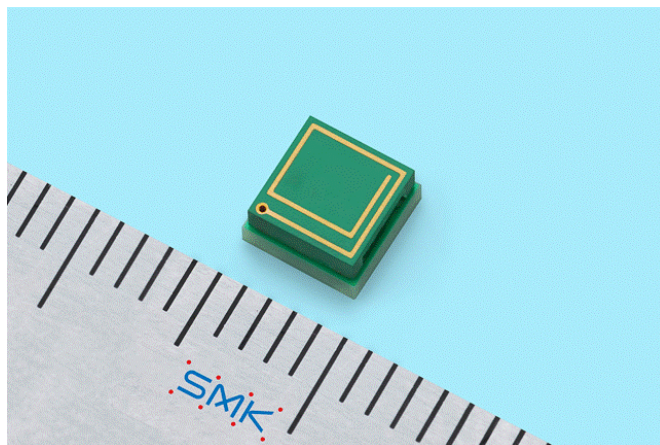


＜新製品情報＞

Bluetooth® low energy モジュール「BTS03 シリーズ」を開発 = 業界最小クラスのアンテナ一体型モジュール =



当社はこのほど、Bluetooth® Version 4.1 LE に準拠し、小型化に特化した Bluetooth® low energy モジュール「BTS03 シリーズ」を開発し、受注を開始します。

本製品は、部品内蔵基板技術の採用と、アンテナを基板直上に配置することで小型サイズ（4.7mm×4.7mm×2.5mm）を実現したアンテナ一体型モジュールです。当社従来品（BTS01）に比べ実装面積を 80%以上削減しました。

本製品は、当社のアンテナ設計技術および高周波設計技術を集約し、安定した高周波特性の確保とモジュールの小型化を両立しました。

当社従来品同様、BTS03 シリーズでは、当社が開発したシリアル通信用アプリケーションを実装したモジュールを提供すると共に、お客様のご要望に応じたソフトウェア開発にも柔軟に対応してまいります。

また、本体および周辺機器への搭載が可能です。（セントラル/ペリフェラルに対応）

本製品は、Bluetooth®認証および電波法（日本）を取得予定であり、お客様のセットでの認証取得が不要です。

今後もお客様のさまざまな要望に対応すべく無線通信用モジュールを拡充してまいります。



注記) Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG Inc.が所有する登録商標であり、SMK 株式会社はこれら登録商標を使用する許可を受けています。

【使用用途】

IoT 機器、ウェアラブル機器、ヘルスケア機器、ワイヤレスセンサー端末、等

発表日	2017年3月23日	
リリース番号	1079RD	
製品名	Bluetooth® low energy モジュール「BTS03 シリーズ」	
特長詳細	<p>1) 部品内蔵基板技術を採用したアンテナ付小型モジュールです。</p> <p>2) 自社開発のシリアル通信用アプリケーションを実装したコンプリートタイプを用意しました。</p> <p>3) 本体および周辺機器への搭載が可能です。 (セントラル/ペリフェラルに対応)</p> <p>4) Bluetooth®認証および電波法(日本)を取得予定です。</p>	
主な仕様	Bluetooth®仕様	Version 4.1 LE
	プロファイル	GAP(Central/Peripheral)、GATT(Client/Server)
	上位 インタフェース	UART /SPI / I ² C
	電源電圧	DC 2.35V ~ 3.3V
	送信出力	+0dBm(Typ.)
	アンテナタイプ	プリントアンテナ
	外形寸法	4.7mm(W)×4.7mm(D)×2.5mm(H)
	動作温度範囲	-20℃ ~ +70℃
	受注活動開始時期	2017年4月
製品レポーター	通信モジュール 製品情報ページ	
お問い合わせ	お問い合わせはこちら	